

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML8

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		2
A-RS-FR4-ML-0.10mm-035+035-TG150-HF	50200647	33	L2	3
		100		
		33	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-106-TG150-HF	50200640	130		4
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		5
A-RS-FR4-ML-0.10mm-035+035-TG150-HF	50200647	33	L4	6
		100		
		33	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	130		7
A-RS-FR4-Prepreg-106-TG150-HF	50200640	0		8
A-RS-FR4-ML-0.10mm-035+035-TG135	50200265	33	L6	9
		100		
		33	L7	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		10
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	RS	11

Dicke nach Verpressen

B00:

890 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

990 µm

Dmin:

790 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1000 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

1100 µm

Dmin:

900 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

896 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik